全球半导体行业月刊

费城半导体指数 10 月下跌 14.64%，存储与设备订单口径上调，四季度 DRAM 合约价预测升至约 20%

发布主体：百思特变革研究院半导体智库 | 期次日期：2026-10-25 | 覆盖窗口：2026-10-01 至 2026-10-25（重点周 10 月 19 日至 25 日） | 截至美东时间 10 月 25 日 21:00（北京时间 10 月 26 日 09:00）

本期总判断

10 月半导体企业的经营数据与股价反向运行。费城半导体指数当月跌 14.64% 至 10,779.5，同月台积电三星电子、Lam Research 与 BESI 的业绩或订单全部高于上季。

一、存储利润创新高，价格预测上调。 三星电子三季度初步营业利润 107.4 万亿韩元，同比增长 782.5%。TrendForce 10 月 20 日把四季度常规 DRAM 合约价预测上调至环比约 20%，9 月 30 日预测为 10%—15%。

二、设备企业订单增长，股价跌幅最大。 Lam Research 九月季度营收 82.19 亿美元、环比增长 22%，十二月季度指引中值 86.0 亿美元。该股 10 月 22 日单日跌 11.76%，当月跌 29.96%。

三、晶圆代工上调全年增速。 台积电三季度营收 467.2 亿美元，四季度指引 523 亿—543 亿美元，2026 年美元营收增速上调至约 44%。

四、出口数据保持三位数增长。 韩国 10 月 1—20 日半导体出口 275 亿美元，同比增长 222.5%；按工作日调整后，总出口日均同比增长 65.9%。

五、美国本月没有新的半导体管制文件。 联邦公报 10 月 19—25 日无实体清单与出口管理条例修订；中国技术出口目录修订草案征求意见至 11 月 15 日。

资本市场： KOSPI 当月跌 18.83%，纳斯达克综合指数跌 3.37%；10 月 22 日费城半导体指数单日跌 6.72%。

宏观约束： 美债 10 年期收益率 10 月 22 日为 4.96%，较 10 月 9 日下行 28 个基点；布伦特现货 10 月 20 日为 115.22 美元。

需要跟踪的关键变量： 10 月 28 日 SK 海力士与 KLA 财报，10 月 29 日三星电子与 Intel 财报，11 月 10 日稀土管制暂停期到期。

本报告基于公开信息编制，仅供研究参考，不构成投资建议。

目录

本月概览.....3
一、本月要点.....7
二、重大事件及其影响.....8
三、行业景气与资本市场.....9
四、存储周期与装备制造链.....10
五、政策、贸易与供应链安全.....10
六、重点企业动态.....11
七、中国半导体产业链.....12
八、行业会议与人物观点.....12
九、趋势判断.....13
十、主要风险与下月关注事项.....14
十一、管理观察与行动建议.....15
数据来源与口径.....15

阅读导引：企业决策层建议优先阅读本月要点、重大事件及其影响、趋势判断与管理观察；制造、存储与设备企业建议重点阅读存储周期与装备制造链、重点企业动态；政策研究者与资本市场研究者建议重点阅读行业景气与资本市场、政策贸易与供应链安全、主要风险与下月关注事项。

百思特管理咨询集团

本月概览

月度关键指标

全球半导体月销售额（8 月，SIA） **1,597 亿美元** **同比 +144.3%，环比 +8.0%** 三个月移动平均；9 月数据 11 月上旬发布	费城半导体指数（10 月 23 日） **10,779.5** **月 −14.64%，周 −3.21%** 9 月 30 日 12,628.6；10 月 6 日月内高点 13,217.8	常规 DRAM 合约价（四季度预测，TrendForce） **环比约 20%** **+5—10 个百分点** 10 月 20 日发布；9 月 30 日预测为 +10%—15%
韩国半导体出口（10 月 1—20 日） **275 亿美元** **同比 +222.5%** 工作日 13 天，较上年多 2.5 天；占总出口 44.7%	Lam Research 九月季度营收 **82.19 亿美元** **环比 +22%** 十二月季度指引中值 86.0 亿美元，环比 +4.6%	三星电子三季度初步营业利润 **107.4 万亿韩元** **同比 +782.5%** 10 月 8 日公布；完整财报 10 月 29 日
台积电三季度营收 **467.2 亿美元** **同比 +50.9%（新台币口径）** 四季度指引 523 亿—543 亿美元	DDR5 16Gb 现货均价（10 月 23 日） **61.267 美元** **周 +1.1%** 10 月 9 日 58.900 美元；DDR4 16Gb 82.870 美元	美债 10 年期收益率（10 月 22 日） **4.96%** **周 −13 个基点** 10 月 16 日 5.09%；10 月 9 日 5.24%

一月大事记（按周，2026 年 10 月 1 日至 10 月 25 日）

第 1 周
10 月 1—4 日

- 10 月 1 日韩国公布 9 月出口 1,209 亿美元、同比增长 83.5%，半导体出口约 603 亿美元、同比增长 263%
- 布伦特原油 10 月 1 日回到 100 美元上方
- 10 月 2 日费城半导体指数收 13,136.7
- 10 月 3 日马斯克称 Terafab 与台积电"只是讨论"
- 中国 A 股 10 月 1—7 日国庆休市

本报告基于公开信息编制，仅供研究参考，不构成投资建议。

第 2 周 10 月 5—11 日	▪ SIA 公布 8 月全球半导体销售额 1,597 亿美元、同比增长 144.3%，1—8 月累计超过 1 万亿美元 ▪ 10 月 6 日费城半导体指数收 13,217.8，为月内高点 ▪ AMD 称产能规划提前 3—5 年 ▪ 10 月 8 日三星电子三季度初步营业利润 107.4 万亿韩元 ▪ 台积电 9 月营收 5,118.6 亿新台币、同比增长 54.6% ▪ 科创 50 10 月 8 日复市单日跌 4.82% ▪ 费城半导体指数周跌 4.30%
第 3 周 10 月 12—18 日	▪ 韩国 10 月 1—10 日半导体出口 121 亿美元、同比增长 170.9% ▪ SEMI 预计 2026 年 300mm 设备支出 1,490 亿美元 ▪ ASML 三季度每股收益 12.95 欧元，称 2027—2028 年供给不足 ▪ TrendForce 预计九大云厂商 2027 年资本开支超过 1.5 万亿美元 ▪ 台积电三季度营收 467.2 亿美元 ▪ 粤芯半导体上市首日涨 223.06% ▪ 中国公布技术出口目录修订草案 ▪ 费城半导体指数连跌 8 个交易日、周跌 11.41%
10 月 19 日 周一	▪ 中国三季度 GDP 同比增长 4.5% ▪ TrendForce 称 2026 年全球光纤缺口 1.8 亿芯公里，短缺延续至 2028 年 ▪ TrendForce 晶圆代工双周报称三星 8 英寸减产并计划涨价，中芯国际 8 英寸与 12 英寸涨价 ▪ 海光信息公布三季度营收 58.56 亿元、同比增长 45.46% ▪ 费城半导体指数涨 1.61% 至 11,316.3
10 月 20 日 周二	▪ TrendForce 预计四季度 DRAM 合约价环比上涨约 20%，二、三季度涨幅分别约 80%、40% ▪ TrendForce 称 NVIDIA Spectrum-X 共封装光学交换机已向部分伙伴出货 ▪ 澜起科技预告三季度归母净利润 12 亿—13 亿元、同比增长 153.6%—174.7% ▪ 据 EE Times Japan 报道，日本拟在 2027—2029 财年向 Rapidus 追加出资 4,000 亿日元 ▪ 科创 50 涨 1.00% 至 1,342.42 ▪ 宏芯宇电子通过港交所聆讯
10 月 21 日 周三	▪ 韩国公布 10 月 1—20 日出口 616 亿美元、同比增长 105.4%，半导体出口 275 亿美元、同比增长 222.5% ▪ 德州仪器三季度营收 60.55 亿美元、同比增长 28% ▪ Lam Research 九月季度营收 82.19 亿美元，十二月季度指引 82 亿—90 亿美元 ▪ NVIDIA 在 GTC Berlin 称 Vera Rubin 已进入完全量产，承诺向欧洲投入近 100 亿美元 ▪ Infineon 与 NVIDIA 扩大 800V 直流 GaN 供电合作 ▪ 费城半导体指数涨 1.97% 至 11,505.6

本报告基于公开信息编制，仅供研究参考，不构成投资建议。

10 月 22 日 周四	▪ 费城半导体指数跌 6.72% 至 10,732.0，Lam Research 跌 11.76%、KLA 跌 9.54%、应用材料跌 8.15% ▪ 纳斯达克综合指数跌 2.60% ▪ KOSPI 跌 3.52% ▪ BESI 三季度营收 2.834 亿欧元、同比增长 113.6%，订单 3.426 亿欧元、环比增长 17.0%，宣布 1 亿欧元回购 ▪ TrendForce 预计 2026 年服务器 CPU 出货增长 31%，Arm 架构份额超过 20% ▪ 据 TrendForce 引述 Nikkei，Micron 称 4F² 不在路线图内 ▪ 科创 50 跌 2.79% 至 1,305.87，创业板指跌 4.37% ▪ 长电科技前三季度净利润 16.17 亿元、同比增长 69.58% ▪ 美债 10 年期收益率降至 4.96%
10 月 23 日 周五	▪ 费城半导体指数收 10,779.5，周跌 3.21%、当月跌 14.64% ▪ 寒武纪前三季度归母净利润 37.15 亿元、同比增长 131.49% ▪ 上证指数盘中最低 3,574.27 后收 3,690.48，科创 50 收涨 3.04%，三市成交 1.97 万亿元 ▪ LX Semicon 出售 60 余项专利，退出碳化硅业务（据 TrendForce 报道）
10 月 24—25 日 周末	▪ 立昂微前三季度归母净利润 1.74 亿元，上年同期亏损 1.08 亿元 ▪ 本周港股通南向资金合计净卖出 170.46 亿港元（据同花顺报道）

本报告基于公开信息编制，仅供研究参考，不构成投资建议。

本月图表

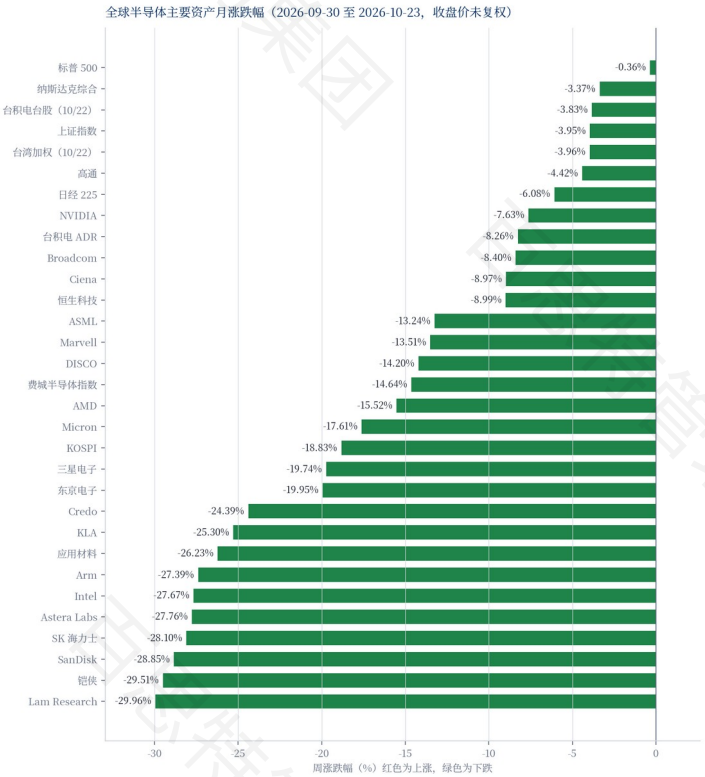

图 1　全球半导体主要资产 10 月涨跌幅（2026-09-30 至 2026-10-23，收盘价未复权；台湾加权与台积电台股为 10 月 22 日收盘；数据来源：investing.com、stockanalysis.com、FRED）

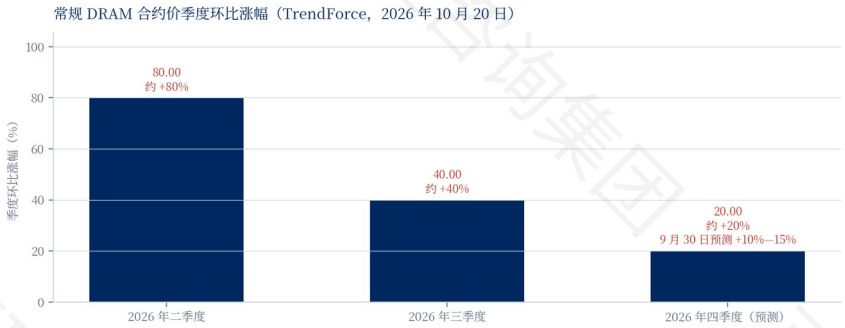

图 2　常规 DRAM 合约价季度环比涨幅（数据来源：TrendForce，2026 年 10 月 20 日；四季度为预测值）

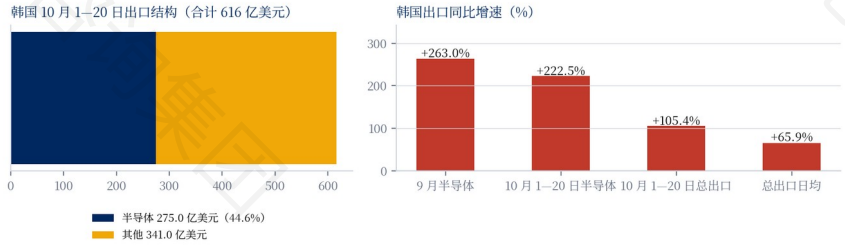

图 3　韩国 10 月 1—20 日出口结构与同比增速（数据来源：韩国出口统计，经 Korea Times 与 Herald Business 报道）

一、本月要点

- **费城半导体指数 10 月下跌 14.64%。** 9 月 30 日收 12,628.6，10 月 23 日收 10,779.5，距 6 月 22 日峰值回撤 26.34%。10 月 22 日单日跌 6.72%，为本月最大单日跌幅。
- **四季度常规 DRAM 合约价预测上调至环比约 20%。** TrendForce 10 月 20 日发布，9 月 30 日的预测为 10%—15%。二、三季度涨幅分别约 80% 与 40%。
- **三星电子三季度初步营业利润 107.4 万亿韩元，同比增长 782.5%。** 营收 195 万亿韩元，同比增长 126 6%，营业利润首次超过 100 万亿韩元。
- **Lam Research 九月季度营收 82.19 亿美元，环比增长 22%。** 十二月季度指引中值 86.0 亿美元，环比增长 4.6%；股价 10 月 22 日跌 11.76%，当月跌 29.96%。
- **台积电 2026 年美元营收增速上调至约 44%。** 三季度营收 467.2 亿美元，毛利率 66.4%；四季度指引 5 23 亿—543 亿美元。
- **韩国 10 月 1—20 日半导体出口 275 亿美元，同比增长 222.5%。** 工作日较上年多 2.5 天，总出口日均同比增长 65.9%。
- **BESI 三季度订单 3.426 亿欧元，环比增长 17.0%。** 营收 2.834 亿欧元，同比增长 113.6%；年初至今混合键合订单超过 2025 年全年的两倍。
- **德州仪器三季度营收 60.55 亿美元，高于一致预期约 2.5%。** 模拟业务同比增长 32%，四季度指引中值与三季度持平。
- **中国芯片设计企业三季度利润增长 38%—148%。** 寒武纪前三季度归母净利润 37.15 亿元、同比增长 131.49%；海光信息 28.47 亿元、同比增长 45.12%。
- **美国 10 月没有发布新的半导体出口管制文件。** 稀土管制暂停期 11 月 10 日到期，本月没有延期安排的公开文本。

10 月四周的股价与经营数据反向。第 1 周韩国 9 月半导体出口同比增长 263%，费城半导体指数 10 月 2 日收 13,136.7。第 2 周 SIA 公布 8 月全球销售额同比增长 144.3%，三星电子三季度初步营业利润 107.4 万亿韩元，指数 10 月 6 日创月内高点后周跌 4.30%。第 3 周台积电上调全年增速，ASML 称 2027—2028 年

供给不足，指数连跌 8 个交易日、周跌 11.41%。第 4 周四季度 DRAM 合约价预测上调至约 20%，Lam 下季增速放缓，指数 10 月 22 日单日跌 6.72%、周跌 3.21%。

二、重大事件及其影响

事件	环节	对产业的影响	来源
三星电子三季度初步营业利润 107.4 万亿韩元（10 月 8 日）	存储	前三季度营业利润 254.13 万亿韩元；10 月 29 日分部利润率决定存储利润是否在四季度见顶	公司初步业绩经 TrendForce
四季度 DRAM 合约价预测上调至约 20%（10 月 20 日）	存储	较 9 月 30 日预测上调 5—10 个百分点；模组厂与服务器厂成本上升	TrendForce
台积电全年增速上调至约 44%（10 月 15 日）	晶圆代工	四季度指引中值环比约 +14%；2nm 占晶圆营收 8%	台积电财报
Lam Research 九月季度营收 82.19 亿美元（10 月 21 日）	设备	下季指引中值环比 +4.6%；次日股价跌 11.76%，KLA、应用材料跌 8%—10%	Lam 财报
费城半导体指数 10 月 22 日跌 6.72%	资本市场	当日纳斯达克跌 2.60%、KOSPI 跌 3.52%；未见可核实的单一触发事件	investing.com、FRED
韩国 10 月 1—20 日半导体出口同比 +222.5%（10 月 21 日）	需求端	工作日多 2.5 天，日均口径低于名义增速	韩国出口统计经 Korea Times
BESI 三季度订单环比 +17.0%（10 月 22 日）	先进封装设备	累计混合键合需求超过 215 台；HBM4E 与 SoIC 采用进度提前	BESI 新闻稿
NVIDIA 称 Vera Rubin 进入完全量产（10 月 21 日）	计算芯片	承诺向欧洲投入近 100 亿美元；HBM4 与 CoWoS 需求随出货节奏释放	NVIDIA 官方博客
NVIDIA 与 Tesla 为三星电机基板产能出资（据报道，10 月 22 日）	封装基板	分别约 2.6 万亿、1.1 万亿韩元；ABF 基板供给偏紧	韩国媒体经 TrendForce
中国技术出口目录修订草案（10 月 16 日）	政策	14nm 及以下或 2.5D/3D 堆叠芯片设计技术出口需审批；征求意见至 11 月 15 日	AP、The Next Web

三、行业景气与资本市场

10 月新发布的高频数据全部为正增长。韩国 10 月 1—20 日出口 616 亿美元，同比增长 105.4%，半导体出口 275 亿美元，同比增长 222.5%，占总出口 44.7%。同期工作日 13 天，上年同期 10.5 天，按工作日调整后总出口日均同比增长 65.9%。台积电 9 月营收 5,118.6 亿新台币，同比增长 54.6%，1—9 月累计增长 41.1%。SIA 公布 8 月全球半导体销售额 1,597 亿美元，同比增长 144.3%，9 月数据 11 月上旬发布。中国 9 月集成电路出口 449.51 亿美元，同比增长 136%，出口数量仅增长 1%。

指标	最新值	期间	同比	来源
全球半导体销售额（三个月均值）	1,597 亿美元	8 月	+144.3%	SIA
韩国半导体出口	275 亿美元	10 月 1—20 日	+222.5%	Korea Times
台积电营收	5,118.6 亿新台币	9 月	+54.6%	台积电
中国集成电路出口	449.51 亿美元	9 月	+136%	金融界
日本制半导体设备销售额	5,979 亿日元	8 月	+47.4%	SEAJ 经 TechNews
DDR5 16Gb 现货均价	61.267 美元	10 月 23 日	周 +1.1%	DRAMeXchange
美债 10 年期收益率	4.96%	10 月 22 日	周 −13 个基点	FRED

指数或标的	10 月 23 日	周涨跌	月涨跌	说明
费城半导体指数	10,779.5	−3.21%	−14.64%	10 月 6 日月内高点 13,217.8
纳斯达克综合指数	25,955.34	−0.71%	−3.37%	10 月 22 日单日 −2.60%
KOSPI	5,550.30	−2.08%	−18.83%	10 月 22 日单日 −3.52%
日经 225	62,693.16	−4.03%	−6.08%	—
恒生科技指数	3,871.66	−5.76%	−8.99%	—
Lam Research	230.10 美元	−12.82%	−29.96%	10 月 22 日 −11.76%
SK 海力士	1,277,000 韩元	+0.39%	−28.10%	10 月 28 日财报
NVIDIA	210.96 美元	−1.48%	−7.63%	Vera Rubin 进入完全量产
台积电 ADR	418.51 美元	+1.43%	−8.26%	—

资本市场的跌幅集中在设备、存储与互连三个板块。设备板块当月跌 25.30%—29.96%，本周跌 7.83%—12.82%，对应 10 月 21 日 Lam 下季增速放缓。存储板块当月跌 17.61%—28.85%，本周跌幅收窄至 −4.72%—+0.39%，同周四季度合约价预测上调。互连板块本周 Credo 跌 13.21%、Astera Labs 跌 10.03%。计算与代工板块本周涨跌在 −2.26%—+2.21%，高通涨 2.21%，台积电 ADR 涨 1.43%。美债 10 年期收益率 10 月 22 日单日下行 17 个基点至 4.96%，同日纳斯达克综合指数跌 2.60%。

四、存储周期与装备制造链

存储价格预测在 10 月上调。TrendForce 10 月 20 日预计四季度常规 DRAM 合约价环比上涨约 20%，9 月 30 日的预测为 10%—15%。二季度与三季度涨幅分别约 80% 与 40%，涨幅逐季收窄。三星电子三季度初步营业利润 107.4 万亿韩元，前三季度累计 254.13 万亿韩元。DDR5 16Gb 现货 10 月 23 日为 61.267 美元，较 10 月 9 日上涨 4.0%；DDR4 16Gb 为 82.870 美元，周跌 0.94%。据 TrendForce 引述 Nikkei，Micron 称 4F² 不在路线图内，1δ 节点 2027 年下半年量产。10 月 28 日与 29 日两家韩国存储厂的财报给出 HBM 出货与 2027 年价格口径。

设备企业的订单增长，股价当月跌幅最大。Lam Research 九月季度营收 82.19 亿美元、环比增长 22%，十二月季度指引 82 亿—90 亿美元，营业利润率指引 40.5%。BESI 三季度订单 3.426 亿欧元，环比增长 17.0%，累计混合键合需求超过 215 台，并宣布 1 亿欧元回购。SEMI 10 月 13 日预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出 1,490 亿美元、同比增长 31%。Lam、KLA、应用材料当月分别下跌 29.96%、25.30% 与 26.23%，东京电子下跌 19.95%。设备板块的检验时点为 10 月 28 日 KLA 与 10 月 30 日东京电子的下季指引。

五、政策、贸易与供应链安全

美国 10 月没有发布新的半导体出口管制或关税文件。联邦公报 10 月 19—25 日无实体清单与出口管理条例修订。同期与半导体相关的 2 份联邦公报文件均为行政程序文件。美国出口管制部门 10 月在联邦公报仅有 1 份文件，内容为钢、铝、铜关税的美国含量认定。半导体 232 关税第二阶段仍无税率与生效日，第一阶段对少数高端人工智能加速器征收 25%。延长 48D 投资税收抵免开工期限的法案尚未通过，现行截止日为 12 月 31 日。

中国 10 月 16 日公布《禁止出口限制出口技术目录》修订草案，共 40 项，其中人工智能 23 项。芯片设计技术门槛为 14nm 及以下或 2.5D/3D 堆叠，征求意见截止日为 11 月 15 日（据 The Next Web 报道）。中美贸易休战已延至 2027 年 1 月 10 日。2025 年 10 月扩围的稀土出口管制暂停期 11 月 10 日到期，镓、锗、锑对美出口限制暂停期 11 月 27 日到期。台湾 10 月 16 日提出把人工智能服务器与先进半导体纳入对大陆出口管制清单，尚无生效日。据 EE Times Japan 报道，日本政府拟在 2027—2029 财年向 Rapidus 追加出资 4,000 亿日元。

六、重点企业动态

企业	本月动态	关键数字	来源
台积电	三季度财报；全年增速上调至约 44%	467.2 亿美元	公司财报
三星电子	三季度初步业绩；8 英寸减产并计划涨价（据 TrendForce）	营业利润 107.4 万亿韩元	公司初步业绩
Lam Research	九月季度财报	82.19 亿美元	公司财报
NVIDIA	Vera Rubin 进入完全量产；欧洲投资近 100 亿美元	部署周期 14 天	公司博客
BESI	三季度财报；1 亿欧元回购	订单 3.426 亿欧元	公司新闻稿
德州仪器	三季度财报	60.55 亿美元	公司财报
Infineon	与 NVIDIA 扩大 800V GaN 合作	机架最高 1 兆瓦	TrendForce
寒武纪	三季报	前三季度净利润 37.15 亿元	公司公告

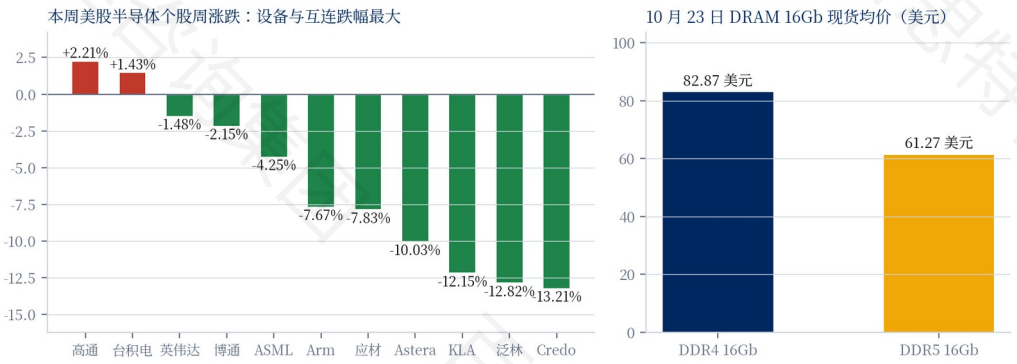

图 4　本周美股半导体个股周涨跌与 DRAM 16Gb 现货均价（数据来源：stockanalysis.com；DRAMeXchange，10 月 23 日）

台积电 10 月 15 日把 2026 年美元营收增速上调至约 44%，资本开支维持 600 亿—640 亿美元。NVIDIA 10 月 21 日称 Vera Rubin 进入完全量产，DSX POD 参考设计把人工智能工厂现场部署周期由 6 个月缩短至 14 天。Infineon 同日宣布与 NVIDIA 开发 800V 直流 GaN 中间母线转换器，2027 年起部署。据韩国媒体经 TrendForce 报道，NVIDIA 与 Tesla 分别为三星电机基板产能出资约 2.6 万亿与 1.1 万亿韩元。TrendForce 10 月 22 日预计 2026 年服务器 CPU 出货增长 31%，Arm 架构份额超过 20%。

七、中国半导体产业链

中国芯片设计企业三季度利润增速高于海外同业。寒武纪前三季度营收 95.26 亿元、同比增长 106.76%，存货由年初 49.44 亿元升至 116.65 亿元。海光信息前三季度营收 149.55 亿元、同比增长 57.58%，经营现金流为 −24.43 亿元。澜起科技预告三季度归母净利润 12 亿—13 亿元，原因为 DDR5 RCD 出货增加。长电科技前三季度净利润 16.17 亿元，同比增长 69.58%。TrendForce 10 月 19 日称，中芯国际 8 英寸与 12 英寸涨价，华虹与合肥晶合满载涨价。

A 股半导体股本周随海外回调。科创 50 10 月 22 日跌 2.79% 至 1,305.87，创业板指跌 4.37%，10 月 23 日科创 50 收涨 3.04%。上证指数 10 月 23 日盘中最低 3,574.27，收盘 3,690.48，当月下跌 3.95%。10 月 13 日粤芯半导体上市首日涨 223.06%，羲禾科技与季丰电子分别于 10 月 14 日、15 日过会。北方华创、拓荆科技与微导纳米 10 月公布的并购与定增合计约 96.7 亿元。江丰电子与长川科技筹划 H 股，宏芯宇电子 10 月 20 日通过港交所聆讯。

八、行业会议与人物观点

10 月有五个行业会议发布产品与技术口径。OCP 全球峰会 10 月 12—15 日在圣何塞举行，NVIDIA 贡献 Vera Rubin 机架设计与 800V 直流参考架构。SEMICON West 10 月 13—15 日在旧金山举行，湾芯展与 SEDEX 同期在深圳与首尔举行。NVIDIA GTC Berlin 10 月 21 日举行，Infineon 同场宣布 GaN 合作。下月有上海进博会（11 月 5—10 日）、慕尼黑 SEMICON Europa（11 月 10—13 日）与北京 ICCAD 2026（11 月 19—20 日）。

企业家对需求的表述偏强。NVIDIA 首席执行官黄仁勋 10 月 21 日在 GTC Berlin 称 Vera Rubin "in full production"。Lam Research 首席执行官 Tim Archer 10 月 21 日称公司有能力跑赢晶圆厂设备市场。台积电董事长魏哲家 10 月 15 日称供需缺口"still quite big"。TrendForce 10 月 19 日称 2026 年全球光纤缺口 1.8 亿芯公里，短缺至少延续至 2028 年。

九、趋势判断

- **存储利润增速在 2026 年四季度至 2027 年一季度见顶。** 前提条件：四季度 DRAM 合约价上涨约 20% 兑现。若 10 月 28—29 日两家韩国存储厂给出 2027 年一季度合约价环比上涨 10% 以上的口径，见顶时点推迟至 2027 年二季度。
- **设备企业四季度营收环比增速回落至 10% 以内。** 前提条件：Lam 十二月季度指引中值环比 +4.6%。若 KLA 与东京电子下季指引环比增长超过 10%，判断修正。
- **台积电 2027 年资本开支超过 800 亿美元。** 前提条件：2nm 产能翻倍按计划推进。若 2027 年 1 月指引低于 750 亿美元，下调先进制程设备需求判断。
- **封装基板与光纤在 2027 年上半年构成加速器出货的约束。** 前提条件：光纤缺口 1.8 亿芯公里，基板新增产能 2027 年二季度起释放。
- **混合键合设备 2027 年订单增速高于前道设备。** 前提条件：BESI 订单环比 +17.0%。若 BESI 四季度订单环比下降，判断推迟。
- **人工智能服务器的 CPU 配比在 2027 年上升。** 前提条件：2027 年服务器 CPU 出货增长 40% 以上。若 AMD 11 月 3 日下调服务器 CPU 指引，判断修正。
- **11 月 10 日前政策节点获得延期安排。** 前提条件：中美贸易休战已延至 2027 年 1 月 10 日。若稀土暂停期到期未延，四季度政策风险判断上调为已发生。

十、主要风险与下月关注事项

风险	本月事实	判断标准	影响对象
设备订单增速放缓	Lam 下季指引中值环比 +4.6%，九月季度 +22%	KLA、东京电子下季指引环比低于 5%	前道设备与零部件企业
估值回撤	费城半导体指数距 6 月峰值回撤 26.34%	回撤超过 30%	股权融资与员工持股激励
政策到期	11 月 10 日稀土、11 月 27 日镓锗锑暂停期	两项均无延期安排	磁材与化合物半导体衬底
基板与光纤短缺	光纤缺口 1.8 亿芯公里	2027 年二季度新增基板产能延期	加速器与光模块出货

日期	事件	关注要点	需要修正判断的情形
10 月 28 日	SK 海力士三季报	HBM4 出货	若 HBM 营收环比下降，存储判断提前
10 月 28 日	KLA 财报	下季指引环比	若环比增长低于 5%，设备放缓判断确认
10 月 29 日	三星电子完整财报；Intel 三季报	存储利润率；资本开支	若存储部门利润率低于 75%，存储判断修正
10 月 30 日	东京电子、铠侠财报	设备订单；NAND 价格	若 NAND 价格指引低于 +15%，价格判断修正
11 月 1 日	韩国 10 月出口	半导体出口金额	若低于 9 月约 603 亿美元超过 10%，出口判断修正
11 月上旬	SIA 9 月销售；10 月 DRAM 合约价	环比增速；成交价	若 10 月合约价环比低于 +10%，四季度判断下调
11 月 10 日	稀土管制暂停期到期	延期安排	若未延期，政策判断上调为已发生
11 月 15 日	技术出口目录征求意见截止	正式文本范围	若芯片设计门槛放宽，合规风险下调

十一、管理观察与行动建议

芯片设计与系统企业面对的是存储与基板成本上升。四季度 DRAM 合约价预测上调至约 20%，系统企业应在 11 月前锁定 2027 年上半年存储采购量与价格区间。NVIDIA 与 Tesla 为基板产能出资，加速器设计企业应把基板与光纤纳入 2027 年供应协议并评估预付款方案。

制造、存储与封测企业的利润处于高位。三星电子三季度初步营业利润 107.4 万亿韩元，存储股当月跌 17 61%—28.85%。存储企业应在财报中分别披露 2027 年 HBM 已签约比例与常规 DRAM 价格口径。成熟制程代工厂满载涨价，可把涨价写入 2027 年合约；封测企业可利用稼动率谈判一年以上的产能协议。

设备与材料企业的订单与股价反向。Lam 九月季度营收环比增长 22%，股价当月跌 29.96%。设备企业应按存储、逻辑与先进封装拆分 2027 年订单口径。BESI 混合键合订单超过 2025 年全年两倍，前道设备企业可评估以合作或并购进入混合键合。

中国产业链企业的利润增长伴随存货上升。寒武纪存货由年初 49.44 亿元升至 116.65 亿元，国产算力企业应在四季度披露存货对应的在手订单。技术出口目录草案征求意见至 11 月 15 日，有海外授权的设计企业应在截止前梳理受影响项目。

政策研究者的关注点在 11 月三个节点：11 月 10 日稀土暂停期、11 月 15 日技术出口目录截止与 11 月 APEC 会议。美国 10 月没有新的半导体管制文件，半导体 232 关税第二阶段仍无税率。

上市公司与资本市场研究者需要处理经营指标与股价的反向。费城半导体指数当月跌 14.64%，同期四项经营指标全部上调。估值模型应加入两项情形：设备企业 2027 年订单持平，以及 2027 年二季度 DRAM 合约价环比转负。

数据来源与口径

本报告涨跌幅为 9 月 30 日或 10 月 16 日收盘至 10 月 23 日收盘，未复权、不换汇；台湾标的以 10 月 22 日收盘计。数据来自公司财报与新闻稿、联邦公报、SIA、TrendForce、DRAMeXchange 与 FRED。行情来自 investing.com、stockanalysis.com 与主流财经媒体。标注"据报道"的信息为单一媒体来源，尚待当事方确认。

本报告由百思特变革研究院半导体智库基于公开信息编制，数据截至 2026 年 10 月 25 日。报告内容仅供行业研究参考，不构成任何投资建议，不代表任何政府机构或监管部门的立场；所涉政策信息均来自公开发布的法规、公告与新闻报道；引用请注明出处。

百思特管理咨询集团